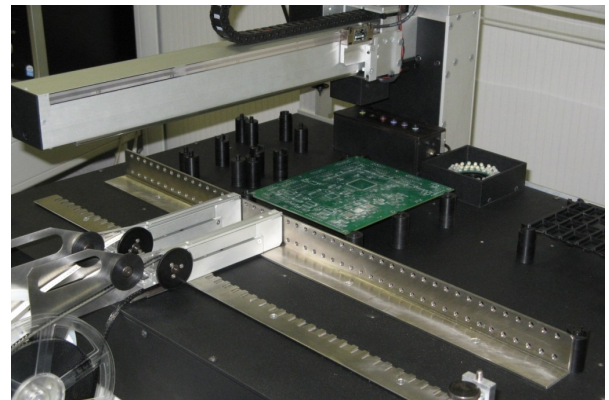
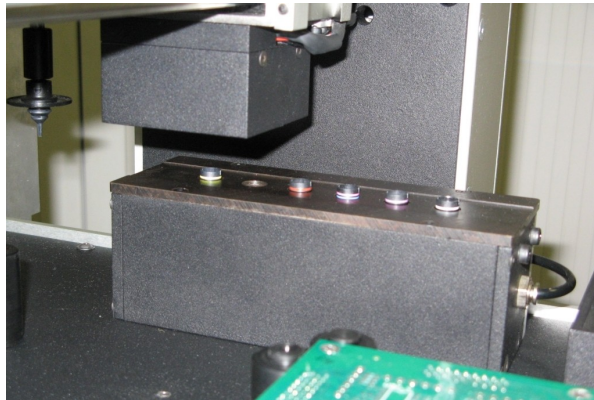
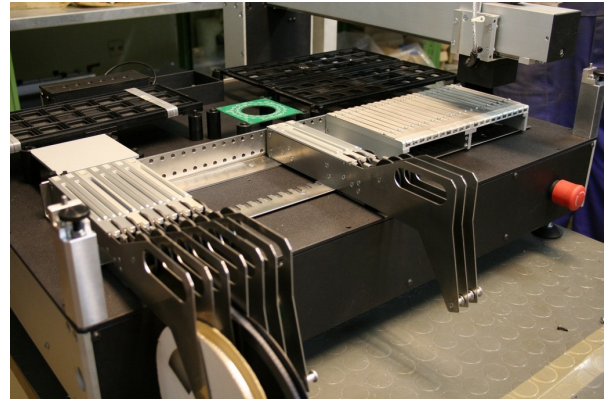


SMD Bestückungsautomat P50



• Technische Daten

- **PCB**
- max. Bestückungsbereich 400 x 500mm
- **Bauelementespektrum**
- von 0402 bis zum 40 x 40mm
- Pitch min. 0,4mm
- BGA / μ BGA
- **Bauelemente Verpackung**
- Gurte / Stangen / Trays
- **Bestückungsrate**
- bis zu 3000 B/Std.
- **Zuführungen**
- bis zu 80 x 8mm – automatik Gurtfeeder und
- 2 x (300 x 200mm) - IC-Tray
bei der Leiterplattengröße: 200 x 300mm
- **Auflösung**
- X / Y Achse - 0,008mm
- **Positionsgenauigkeit**
- +/- 0,08 mm
- **Abmessungen und Gewichte**
- 1040 x 750 x 430 mm / ca. 145 kg
- **Versorgung**
- 230 V - 50 Hz - 350 W / 0,6 Mpa -15 l/min

• Eigenschaften

- **SMD – Bestückungssystem**
- **Unterbau**
- **automatischer Bestückungskopf**
- **automatischer Pipetenwechsler (2x 6-fach)**
- **Kamerasystem für automatische Referenzpunktkorrektur**
- **Kamerasystem für berührungslose Bauelementezentrierung**
- **Bildverarbeitungssoftware**
- **CAD – Editor für Gerber- und Bestückungsfiles**
- **Intelligentes Feedersystem – CAN Bus**
- **Betriebssystem: Windows XP**
- **Bedienungsfeld: PC, Tastatur, Maus und 17" LCD monitor**
- **Anwendungsbereich**
- Klein- bis Mittelserien
- Bestückung von Standard SMD und Finepitch-komponenten inkl. BGA, μ BGA, QFN